⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 152111

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)7月7日

H 01 F 15/04 H 05 K 1/16 3/46 B-6736-5F 7342-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

49発明の名称

の発

髙周波コイル

创特: 헲 昭60-293739

29出 殂 昭60(1985)12月26日

勿発 明 者 木 村 79発 眀 老 B 辺 根 仍発 明 者 加

門真市大字門真1006番地 知 弘 造 門真市大字門真1006番地 謙 丈 門真市大字門真1006番地 門直市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内 松下電器產業株式会社内 松下電器產業株式会社内 松下電器産業株式会社内 松下電器產業株式会社内

明 者 橋 本 の発 所

者

明

甶 芳 宏

門真市大字門真1006番地

创出 顖 人 松下電器産業株式会社

別

門真市大字門真1006番地

の代 理 人 弁理士 中尾 敏男

外1名

明 3

し、発明の名称 高周波コイル

2、特許請求の範囲

(1) 多層回路基板の対向する2つの内層導体層 (以下、第2 導体層、第3 導体層と称す) に夫 々、断続された平行導体を形成する際に、第2 募体層平行導体の格ラインと第3導体層の各ラ イン (以下、平行退体の各ラインを端部より順 次、第1ライン、第2ライン、第3ライン…… と称す)の間に、第2選体層の第Nラインと第 3 疎体層の第Nライン (Nは1より始まる正整 数)の各始点が夫々対向し、第2導体層第Nラ インと第3導体層第 (N-1) ラインの各株点 が失々に対向するよう一定の角度を持たせて上 記平行專体を形成し、上記第2導体層各ライン と第3導体暦各ラインの互いに対向している各 始点および終点を夫々スルーホール接続するこ とにより、第234体層および第334体層に形成 された平行導体と、第2群体と第3導体層間の 第2絶縁体層と、上記スルーホールでもって矩 形断面を有するソレノイド型の第1のコイルを 形成儿, 的配集 2 路最体層から前配第 2 液体層 を挟む位置に設けられた第1絶縁体層と、前記 第2選体層から前記第1絶縁体層を挟む位置に 設けられた第1週体層と、前記第2路縁体層か ら前記第3導体層を挟む位置に設けられた第3 絶縁体層と、前記第3導体層から前記第3絶縁 体層を挟む位置に設けられた第4歳体層を有し、 前記第1導体層および前記第4導体層を前記第 1のコイルに対し電磁シールドの役割りを有す るシールド暦とし、前記第1のコイルにおける 前記第2 導体層、第3 導体層、第4 導体層、第 1 絶縁体層、第2 絶縁体層、第3 絶縁体層と夫 々同様の構造で第5萬体層。第6萬体層。第7 導体層、第4路緣体層、第5題緣体層、第6艳 緑体層と、前記第3絶縁体層から第4導体層を 抜む位置に第4箱縁体層、第5選体層、第5箱 緑体層, 第6 導体層, 第6 絶縁体層, 第7 導体 暦の順に配置し、前記第1のコイルと同様に第

5 導体層と第6 導体層と第5 絶縁体層によって 形成される第2 のコイルと、前記第4 事体層お よび第7 導体層を前記第2 のコイルに対し電磁 シールドの役割りを有するシールド層として用 い、同様の手順で複数個のコイルを多層に積み 重ねたことを特徴とした高周波コイル。

- ② コイルのシールド効果を高めるため、コイル 周辺部において、各シールド層の導体間に多数 のスルーホール接続を施すことを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載の高周波コイル。
- (3) 各コイルの任意の部分にタップを設けること を特徴とする特許結束の範囲第1項記載の高周 カコイル

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は多層回路基板を利用した高周波プリント コイルに関するものである。

従来の技術

近年、電子機器の小型薄型化指向は著しく、そ のためそれらの機器を構成する高周波回路ブロッ

イル端子となるため、使用時にはスルーホールあるいはジャンパー線などを用いて他の回路部と接続されるが、図ではそれらの詳細については省略する。

発明が解決しようとする問題点

第3図に示す平面型プリントコイルの問題はコイルに流れる電流により生ずる従来の主要部が回路基板面と垂直方向に生ずるため、このコイル部を有する回路基板に近接して、源体、磁性体を配置するとその影響を強く受け、そのインダクタンス、コイルのQが大幅に変化するため薄型電磁シールドを施しにくいと云う点にある。また、同様にコイルを多層化するのは難しい。

本発明は上記欠点を除去し、電磁シールド機能 を有する多層高周波コイルを提供することを目的 とする。

問題点を解決するための手段

多層回路基板の対向する2つの内層導体層(以下、第2、第3導体層と称す)に夫々断続された平行政体を形成する際に、第2層、第3層平行選

ク、たとえば受信機フロントエンド部、チューナ 部などの高周波回路部に対する小型化、薄型化要 望は極めて強くなってきた。

これら高周波回路部を小型化、薄型化するための主要課題は、コイルの小型化、薄型化、薄型電磁シールド技術の確立、トリマコンデンサなどで代表される調整用回路素子の小型化、薄型化または回路上の工夫による無調整化などがある。

上述の諸課題の中でも、コイルの小型化、薄型 化に対してはこれまでに多くの試みがなされてき たが、とりわけリードレス構造のチップコイルと プリントコイルの分野でその進歩は著しい。

本発明はブリントコイルに関するものであるため、従来のブリントコイルにつき、まず説明する。

第3図は従来より高周波分野でよく用いられている平面型プリントコイルのパターン図である。 第3図において11は回路基板、12はその表面に形成された導体パターンでありプリントコイルとしての働きを有する。12の導体パターンの中心部は、導体パターンの最外周の終端部と共にコ

作用

本発明は上記のような短形状断面を有する薄型 ソレノイド状コイルを形成し、コイルに流れる電 流により生ずる磁束の主要部を回路基板面と平行 方向に生ぜしめることにより、シールド層として 近接して導体層を配置してもそれにより受ける影響を少なくし、もって薄型電磁シールドの練され た高周波コイルを実現し、また、多層化すること によって更に高密度化を図ることができる。

実施保

以下、本発明の一実施例につき、図面を参照しながら説明する。

スルーホール、そして 1.8_A . 1.8_B は、電磁シールド用として使用される第7源体層の一部が島状に除去された部分と設けられたコイル電極を示す。

第2図は、第1図に示す7層回路基板の内部にコイルが形成されたシールド機能付き高周波コイルの外限を斜視図で示したものであり、第2図の各番号は第1図のそれと同じものであり、詳述は省略する。

以上のようにして多層回路基板内に薄いソレノイド形コイルを形成することにより、コイルに流れる電流によって生ずる主磁東は第2 薄体層と第3 導体層間の絶縁層とその近辺の絶縁層部分に閉じ込められるため、コイルに近接して電磁シールド用導体層を配置してもコイルはその影響を強く受けにくく多層化が可能になり、薄型電磁シールドの徒された多層高周波コイルを得ることができる。

以上の説明においては、コイル電極を第1導体 層および第7導体層に導出する一例を説明したが、 8 B は、電磁シールド用として使用される第1事 体層の一部が島状に除去された部分と設けられた コイル電極を示す。

1g. 1g. 1g は夫々、第5. 第6. 第7導 体層を示し、2はこれらの導体層間に決まれてい る絶縁暦、13_A、13_B、13_C、13_Dは、 第5導体層1度を用いて形成された平行導体の第 1、第2、第3、第4ライン、14A、14g・ 14 cは第6導体層1gを用いて形成された平行 退体の第1、第2、第3ライン、15_A~15_C および 1 5 p ~ 1 5 p は夫々、平行導体の各ライ ン13A~13Dおよび14A~14cの各始点、 終点の嫡郎を電気的に接続するためのスルーホー ル、16g、16gはコイル電極を外部にとり出 すため、第5導体暦と第6導体暦に形成された平 行導体の論部を電気的に接続するためのスルーホ -ル、7は、電磁シールド用として使用される第 1 導体層と、同じく電磁シールド用として使用さ れる第4導体層と同じく電磁シールド用として使 用される第7導体層とを電気的に接続するための

例えば基板の側面に選出するなどの設計変更は使用目的に応じ容易になしうるのは云うまでもない。

また、同様の手順で3つ以上のコイルを積み重ねることができるのは云うまでもない。

また、電磁シールド用の第1、第4、第7専体 履を回路のアースに接続するための電極について は特に貫及しなかったが使用目的に応じ種々の形 をとりうることは容易に理解できるであろう。 さらに実施例では電磁シールド用の第1、第4、 第7専体層を1コのスルーホールにより接続する 方法につき説明したが、これは図面を簡単にする ためのものであり、コイルの周辺に多数のスルー ホールを設けた方がよりシールド効果が向上する たいの任意の点にタップを設けるなどの変更が本発 明に含まれるのは云うまでもない。

発明の効果

以上のように本発明は多層回路基板内に矩形断 . 面を有するソレノイド形コイルを形成することに より、そのコイルに近接して電磁シールド用導体 を配置することができ、多層回路基板を活用して 極めて薄型の電磁シールド機能付きの多層高周波 コイルを形成することができる。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例による高周波コイルの構造を概念的に示す斜視図、第2図は第1図に 芬づく高周波コイルの外観を示す斜視図、第3図 は従来の平面プリントコイルを示す斜視図である。

1 A 、 1 B 、 1 C 、 1 D 、 1 B 、 1 F 、 1 g …
… 溥体暦、 2 … … 絶縁層、 3 A ~ 3 D 、 1 3 A ~

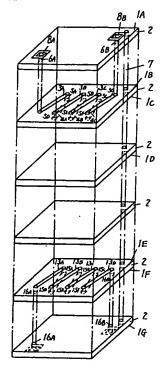
1 3 D 、 4 A ~ 4 C 、 1 4 A ~ 1 4 C … … 平行導体、 5 A ~ 5 F 、 6 A 、 6 B 、 1 5 A ~ 1 5 F 、

1 6 A 、 1 6 B 、 7 … … スルーホール、 8 A 、

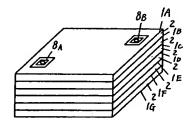
8 B 、 1 8 A 、 1 9 B … … コイル電極。

代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 ほか1名

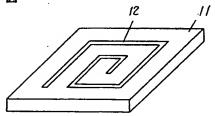
第 1 図



第 2 図



第 3 図



PAT-NO:

JP362152111A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62152111 A

TITLE:

HIGH FREQUENCY COIL

PUBN-DATE:

July 7, 1987

INVENTOR-INFORMATION: NAME KIMURA, TOMOHIRO TANABE, KENZO KANE, JOJI HASHIMOTO, KOJI BESSHO, YOSHIHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP60293739

APPL-DATE:

December 26, 1985

INT-CL (IPC): H01F015/04, H05K001/16, H05K003/46

US-CL-CURRENT: 336/180

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a very thin type multilayer coil having an electromagnetic shielding function by a method wherein the proximity arrangement of a coil and an electromagnetic shielding conductor can be made possible by providing a solenoid coil, with which the magnetic flux is generated in parallel with the surface of a substrate, on a multilayer circuit substrate.

CONSTITUTION: A multilayer circuit substrate is composed of the insulating layers 2 pinched by conductive layers 1A, 1B∼1G and each conductive layer. Lines 3A and 3B∼3D/4A∼4C in parallel with each other are provided on the conductive layers 1B and 1C, the starting points of the lies 3A and 4A are electrically connected using a through hole 5A, and the ending points of the lines 3B and 4A are electrically connected using a through hole 5E. A solenoid type coil having rectangular cross section is formed by successively connecting the starting point and the ending point of each lines as above-mentioned through the intermediary of the insulating layers 2, and also the coil electrodes 8A and 8B provided on the electromagnetic shielding conductor layer 1A are connected to the end part of the <u>coil</u>. As a result, the direction of the magnetic flux generated on the <u>coil</u> is brought in parallel with the surface of the substrate, and the <u>shielding conductive layer</u> 1A can be arranged in close vicinity to the <u>coil</u> without having no influence of the effect of the <u>coil</u>.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio